

配線・電極形成用ペースト

ディスプレイやモバイル用途等に最適！

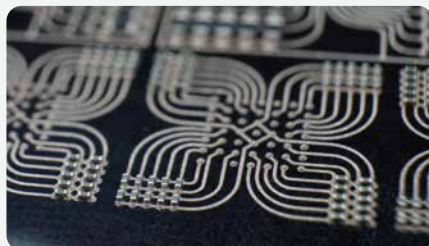
用途

配線・アンテナ形成 下記以外の用途にも幅広く適用可能（例：ヒーター形成など）

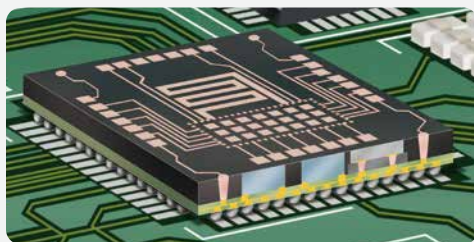
ディスプレイ用 LED 素子連結配線形成



ガラス基板上への配線形成



半導体パッケージ上へのアンテナ形成



特徴

- PET、COP、PEN 等の**低耐熱基材**が使用でき、**優れた密着性**を発揮。
- **めっきシード層**に使用でき、さらなる低抵抗化を実現。
- **ファインパターン**の形成が可能。(L/S=75/75 μ m)

ラインナップ&特性

製品型番			SW180	SW180T7	SW601
タイプ			ファインライン形成タイプ	薄膜タイプ	柔軟タイプ
粘度	BH型	dPa·s	1,300 ~ 1,700	1,000 ~ 1,400	
体積抵抗率 [代表値]	硬化（乾燥）条件 130deg. C × 30min.	$\Omega \cdot \text{cm}$	8.0E-05	6.0E-05	5.0E-05

